

PSA

PASSIVE SYSTEM ALLIANCE

HannStar Board Corporation

瀚宇博德(5469)

2018年法人說明會

2018/5/11

免責聲明

本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際表現、財務狀況或營運結果將可能明顯不同於該對未來展望的表述內容。

除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。

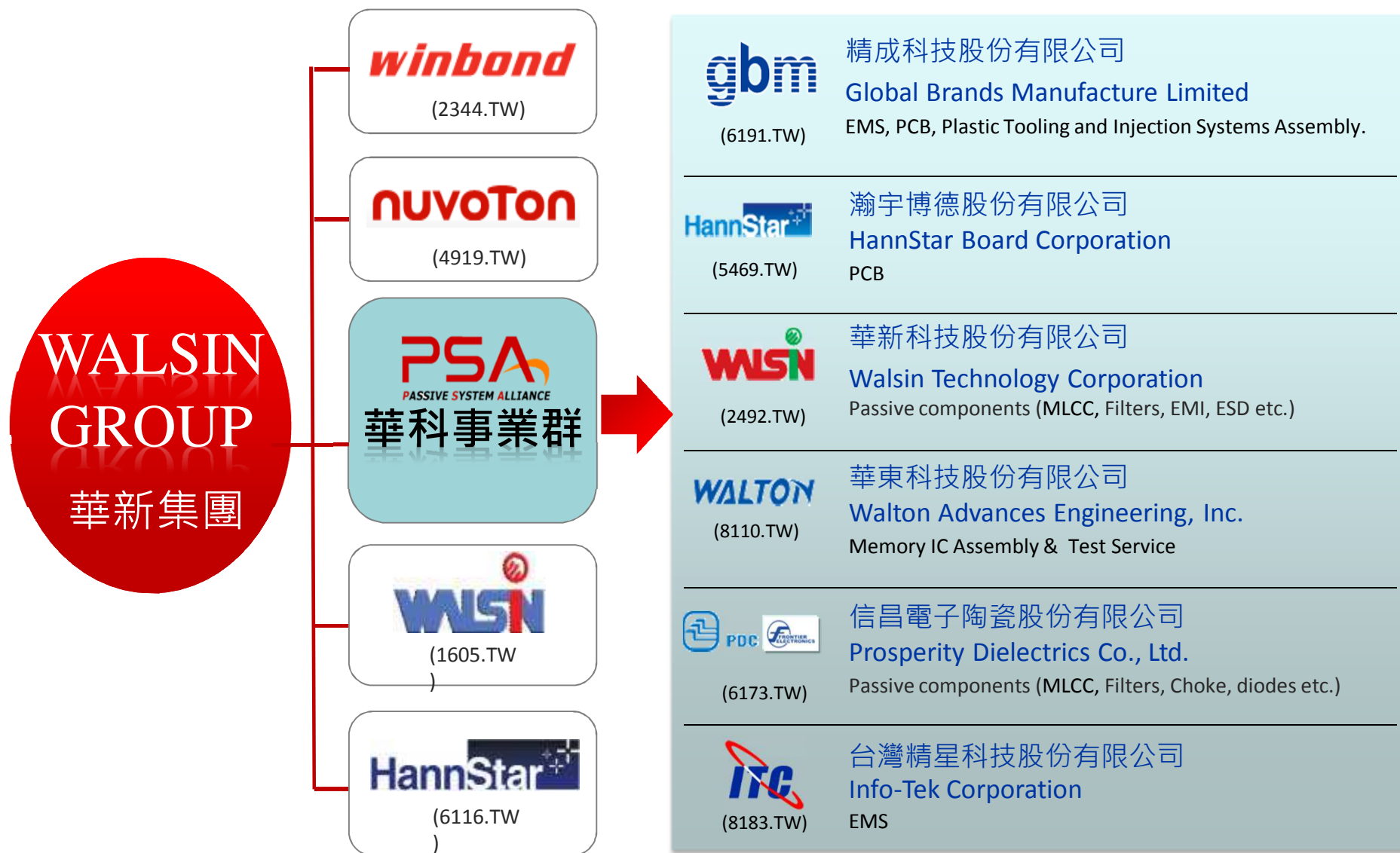
歷史事件的陳述可能包括未經會計師審閱之資訊，其可能有某些不足或缺陷而無法忠實呈現目前瀚宇博德股份有限公司之財務狀況或營運結果。

簡報內容

- 公司概况.....P05
- 財務報告.....P10
- 營運與展望P18

公司概況

集團簡介



公司概況

2018

子公司「精成科技(6191)」投資日本ELNA Co. Ltd. 70%股權。

2017

全球印刷電路板供應商排名前14強

2011

子公司「瀚宇博德國際控股」於香港下市

2010

投資上市公司-精成科技(6191)40%股權，成為最大股東

2006

子公司「瀚宇博德國際控股」於香港交易所主板上市，並成為全球最大筆記型電腦印刷電路板供應商

2003

台灣瀚宇博德由上櫃公司轉為上市公司

2002

大陸子公司「江陰博德」成立

2001

台灣瀚宇博德股票掛牌上櫃買賣

1998

由華新麗華集團收購並更名為「瀚宇博德」

1989

「太平洋科技工業股份有限公司」成立

營業項目

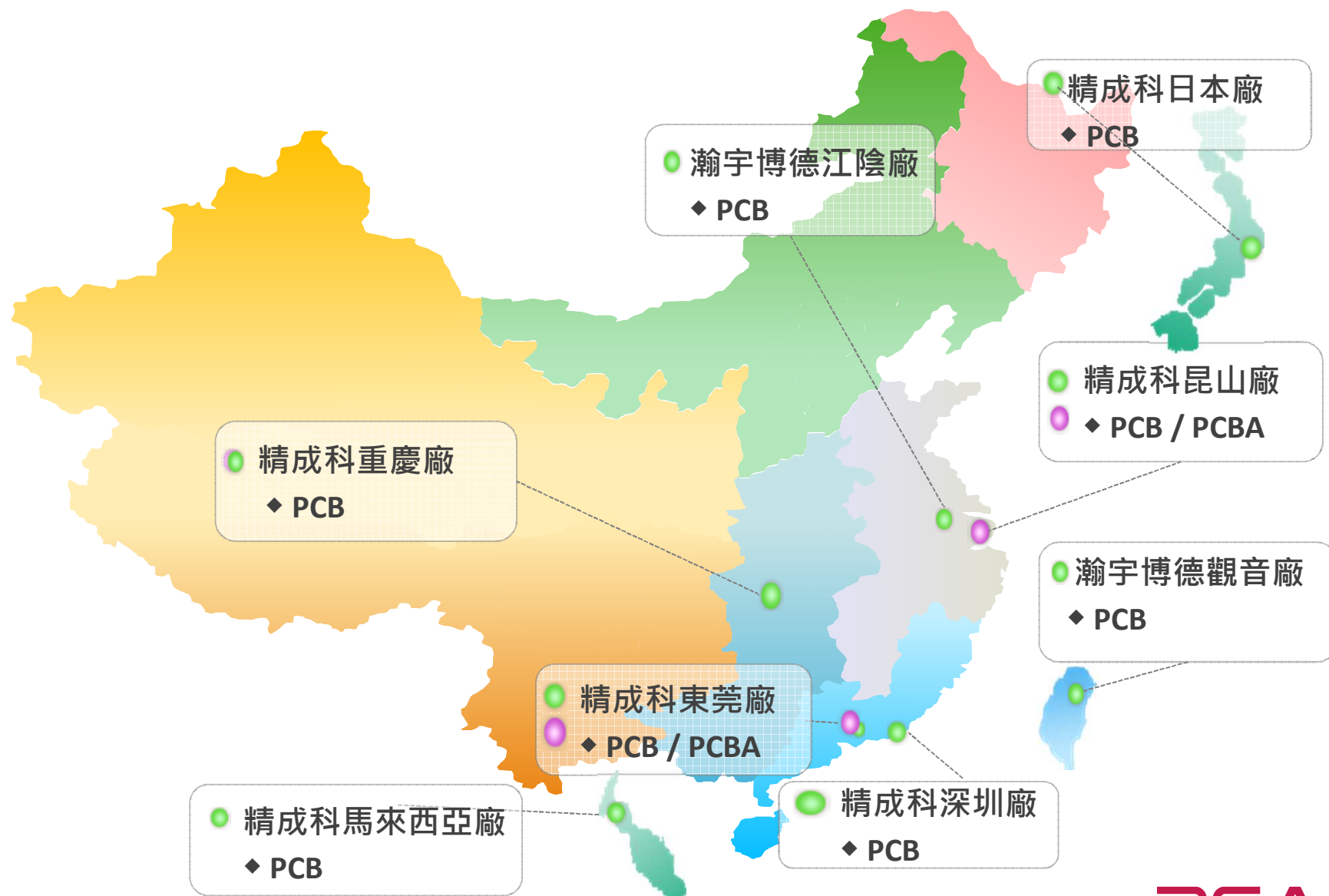
瀚宇博德專注於生產多層印刷電路板、高密度連結板。產品廣泛應用於個人電腦、機上盒、網通設備、遊戲機、液晶電視等多種資訊及消費性電子產品。近年更跨足伺服器及光電板等多個不同領域。



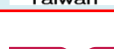
PSA

HannStar Board Corporation

生產基地



2017年全球PCB排名

Rank	Maker	Country
1	Zhen Ding Technology	 Taiwan
2	Nippon Mektron	 Japan
3	TTM Technologies	 USA
4	Unimicron	 Taiwan
5	Compeq	 Taiwan
6	Tripod	 Taiwan
7	SEMCO	 Korea
8	Sumitomo Denko	 Japan
9	Fujikura	 Japan
10	AT&S	 Austria
11	Ibiden	 Japan
12	M-Flex	 USA
13	Meiko	 Japan
14	Hannstar (PSA)	 Taiwan

Source: Prismark 2018

財務報告

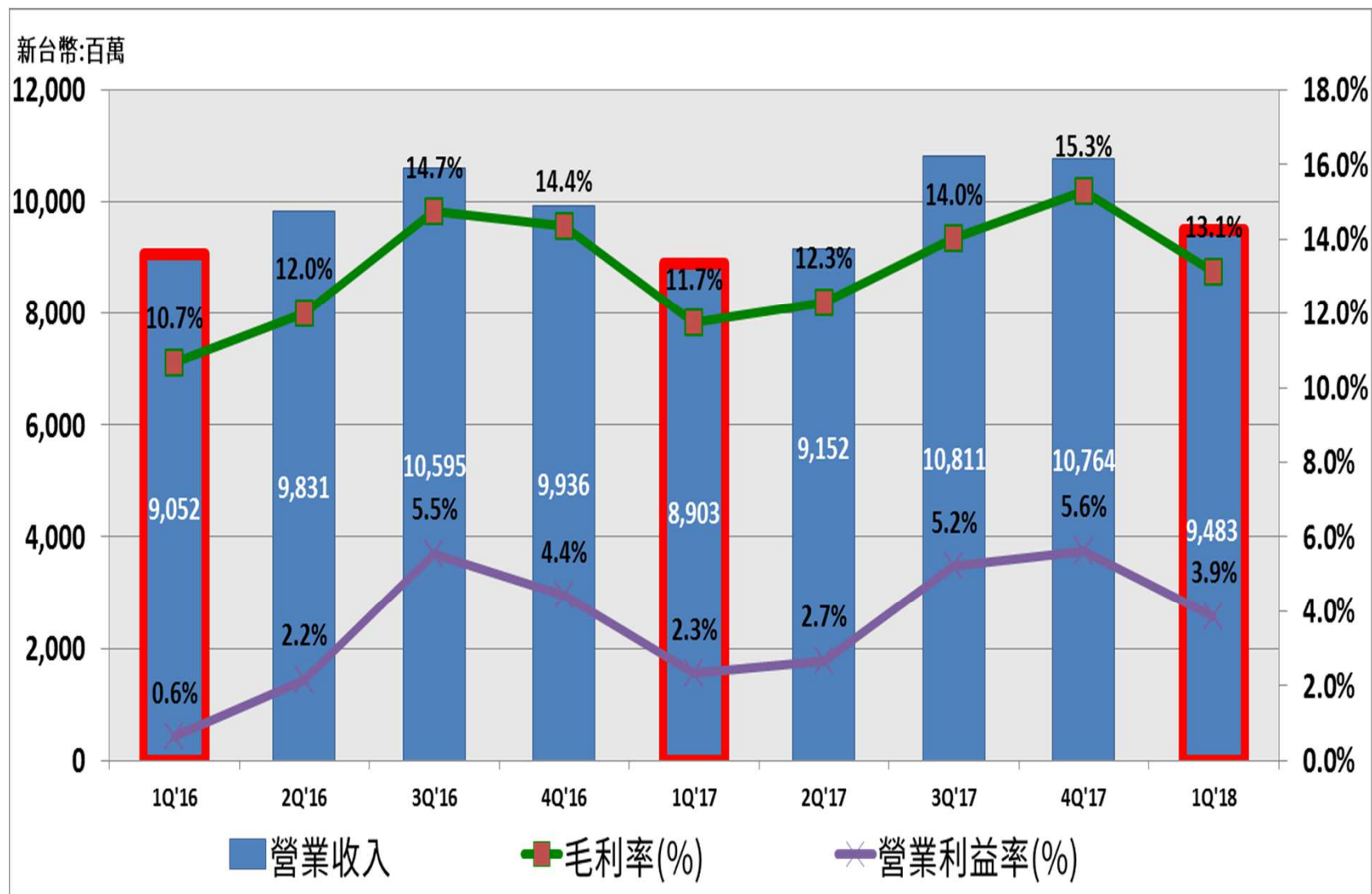
合併損益比較(YoY)

新台幣：百萬	2016	2017	年成長(%)	1Q'18
營業收入	39,415	39,629	1%	9,483
營業毛利	5,135	5,335	4%	1,246
營業淨利	1,295	1,621	25%	366
稅前淨利	1,643	1,693	3%	315
合併淨利	1,257	1,088	-13%	194
歸屬母公司純益	945	856	-9%	141
來自精成科貢獻	219	168	-23%	38
來自博德貢獻	726	688	-5%	103
每股盈餘(元)	2.10	1.90	-10%	0.31
毛利率(%)	13.0%	13.5%	0.5%	13.1%
營業利益率(%)	3.3%	4.1%	0.8%	3.9%
淨利率(%)	3.2%	2.7%	-0.5%	2.0%

合併損益比較(by Q)

	2016				2017				2018
新台幣：百萬	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
營業收入	9,052	9,831	10,595	9,936	8,903	9,152	10,811	10,764	9,483
營業毛利	966	1,181	1,561	1,426	1,046	1,127	1,515	1,647	1,246
營業淨利(損)	57	212	588	439	207	245	564	606	366
稅前淨利(損)	92	278	669	605	191	281	601	620	315
合併淨利(損)	59	205	519	474	107	97	427	457	194
歸屬母公司純益(虧損)	27	165	411	342	125	62	326	343	141
來自精成科貢獻	25	28	75	91	(10)	25	71	82	38
來自博德貢獻	2	137	336	251	135	37	254	261	103
每股盈餘(虧損)(元)	0.06	0.36	0.92	0.76	0.28	0.14	0.72	0.76	0.31
毛利率(%)	10.7%	12.0%	14.7%	14.4%	11.7%	12.3%	14.0%	15.3%	13.1%
營業利益率(%)	0.6%	2.2%	5.5%	4.4%	2.3%	2.7%	5.2%	5.6%	3.9%
淨利率(%)	0.6%	2.1%	4.9%	4.8%	1.2%	1.1%	4.0%	4.2%	2.0%

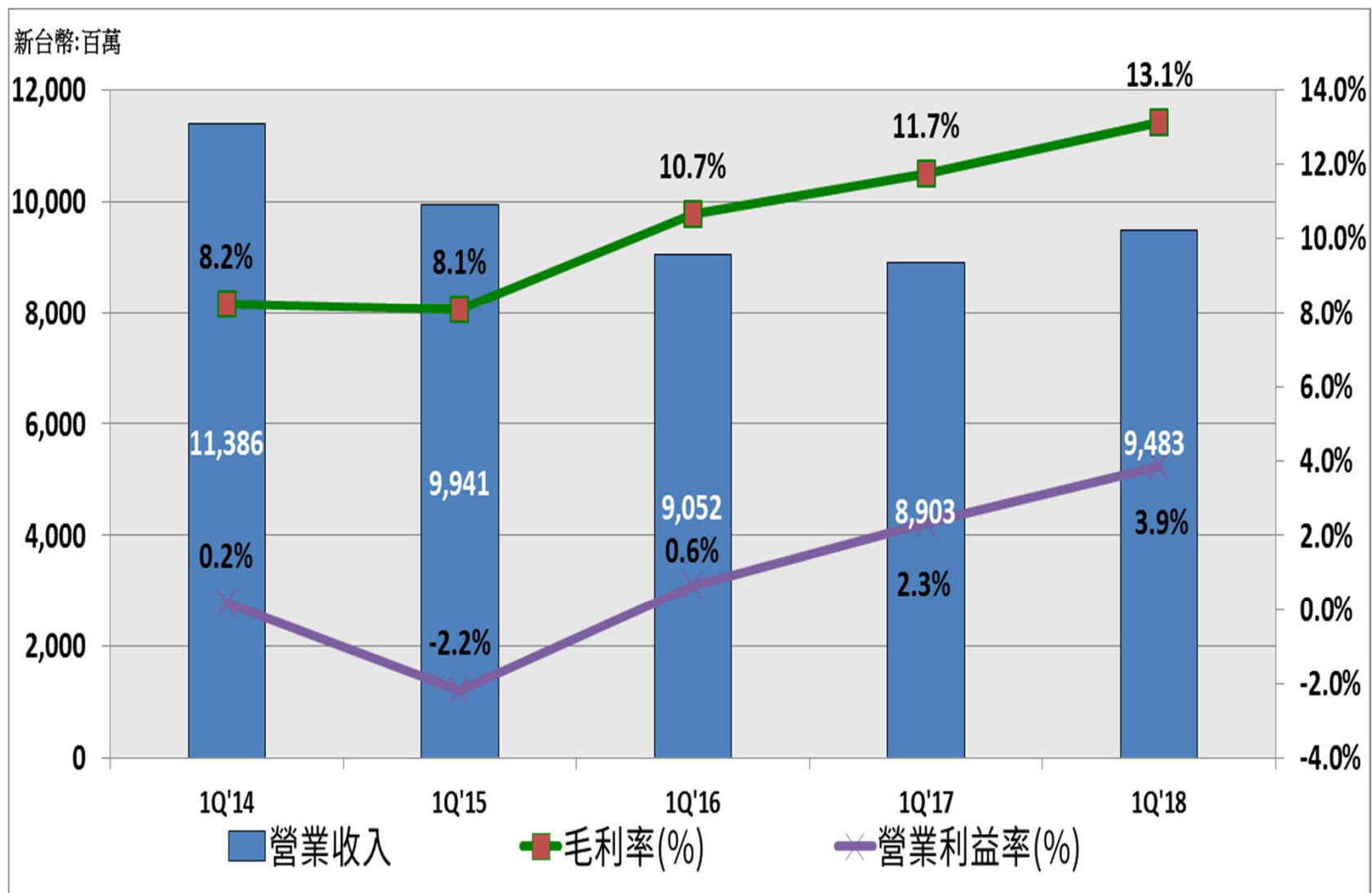
合併營收與各項比率趨勢(各季)



合併損益同期比較-第1季

新台幣：百萬	1Q'14	1Q'15	1Q'16	1Q'17	1Q'18
營業收入	11,386	9,941	9,052	8,903	9,483
營業毛利	938	805	966	1,046	1,246
營業淨利(損)	19	(217)	57	207	366
稅前淨利(損)	46	(121)	92	191	315
合併淨利(損)	13	(170)	59	107	194
歸屬母公司純益(虧損)	23	(32)	27	125	141
來自精成科貢獻	(7)	(89)	25	(10)	38
來自博德貢獻	29	58	2	135	103
每股盈餘(虧損)(元)	0.05	(0.07)	0.06	0.28	0.31
毛利率(%)	8.2%	8.1%	10.7%	11.7%	13.1%
營業利益率(%)	0.2%	-2.2%	0.6%	2.3%	3.9%
淨利率(%)	0.1%	-1.7%	0.6%	1.2%	2.0%

第1季同期營收與各項比率趨勢



合併資產負債表

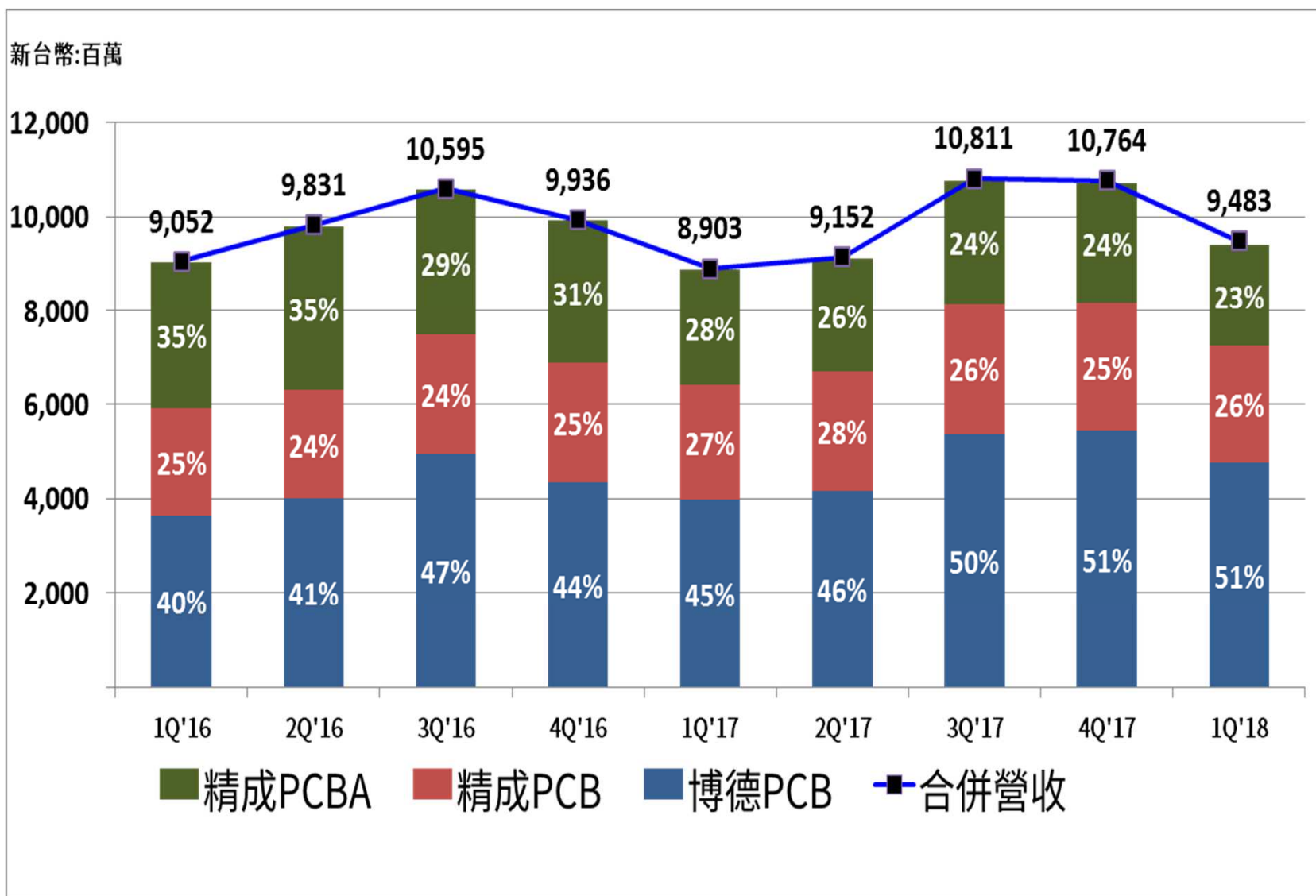
新台幣：百萬	Dec.31 '16	%	Dec.31 '17	%	Mar.31 '18	%
流動資產	33,561	63%	35,004	61%	35,117	60%
非流動資產	19,469	37%	22,390	39%	23,599	40%
資產總計	53,030	100%	57,395	100%	58,716	100%
流動負債	22,964	43%	23,039	40%	23,089	39%
非流動負債	9,819	19%	10,827	19%	10,861	18%
負債總計	32,783	62%	33,866	59%	33,949	58%
本公司業主權益	12,433	23%	15,618	27%	16,744	29%
非控制權益	7,814	15%	7,911	14%	8,022	14%
權益總計	20,247	38%	23,529	41%	24,766	42%
負債與權益總計	53,030	100%	57,395	100%	58,716	100%
每股淨值(元)	27.60		34.67		37.17	

合併現金流量表

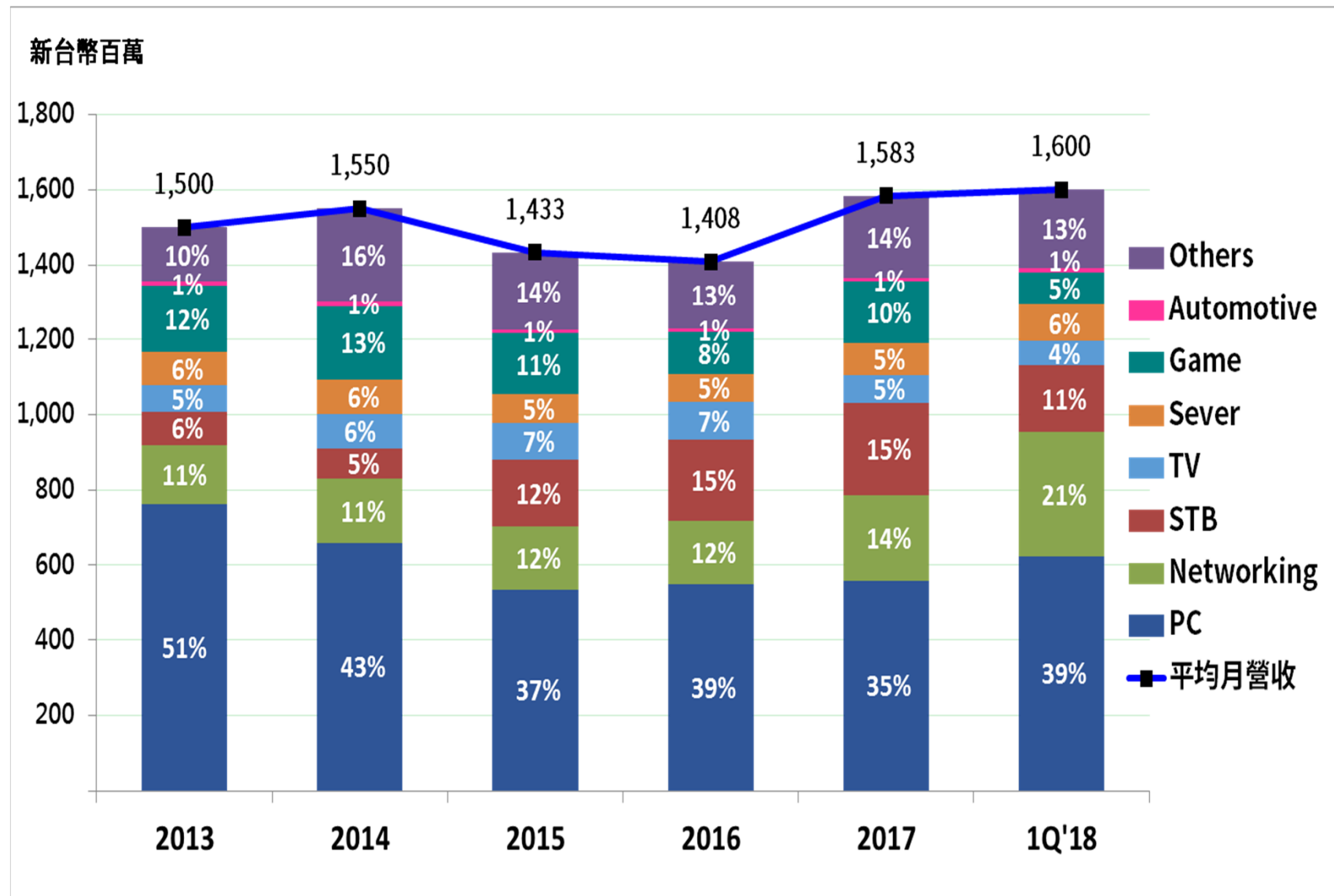
新台幣：百萬	2016	2017	1Q'18
營業活動之淨現金流入(出)	4,950	1,000	1,198
投資活動之淨現金流入(出)	(1,413)	(1,815)	(895)
籌資活動之淨現金流入(出)	(2,896)	(330)	659
其他	(1,092)	(403)	75
現金及約當現金變動	(451)	(1,547)	1,037
期初現金及約當現金餘額	9,935	9,484	7,937
期末現金及約當現金餘額	9,484	7,937	8,974

營運與展望

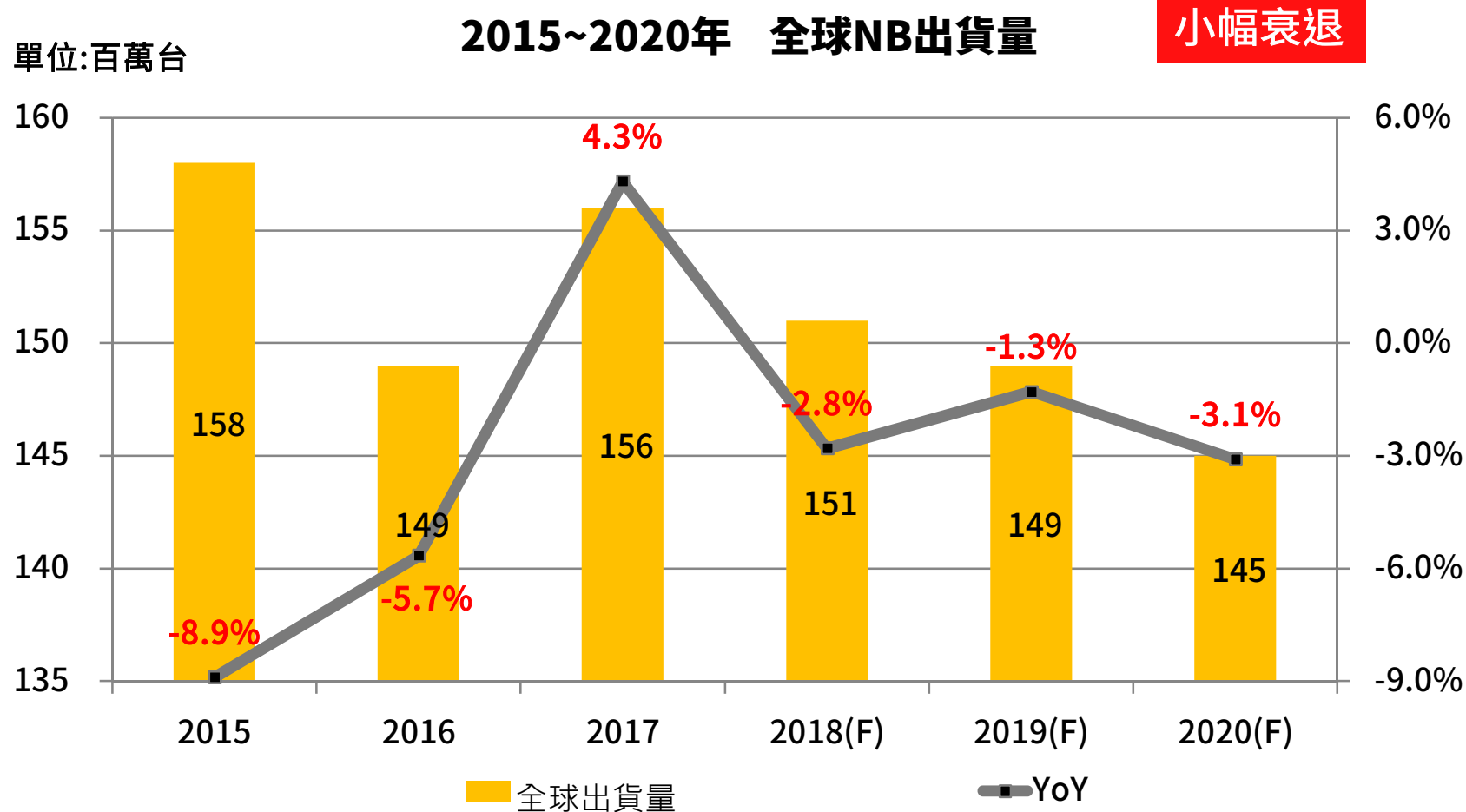
合併營收趨勢(瀚宇博德+精成科)



近年產品組合趨勢(瀚宇博德)



產業現況-NB



單位:百萬台	2015	2016	2017	2018(F)	2019(F)	2020(F)
全球出貨量	158	149	156	151	149	145
YoY	-8.9%	-5.7%	4.3%	-2.8%	-1.3%	-3.1%

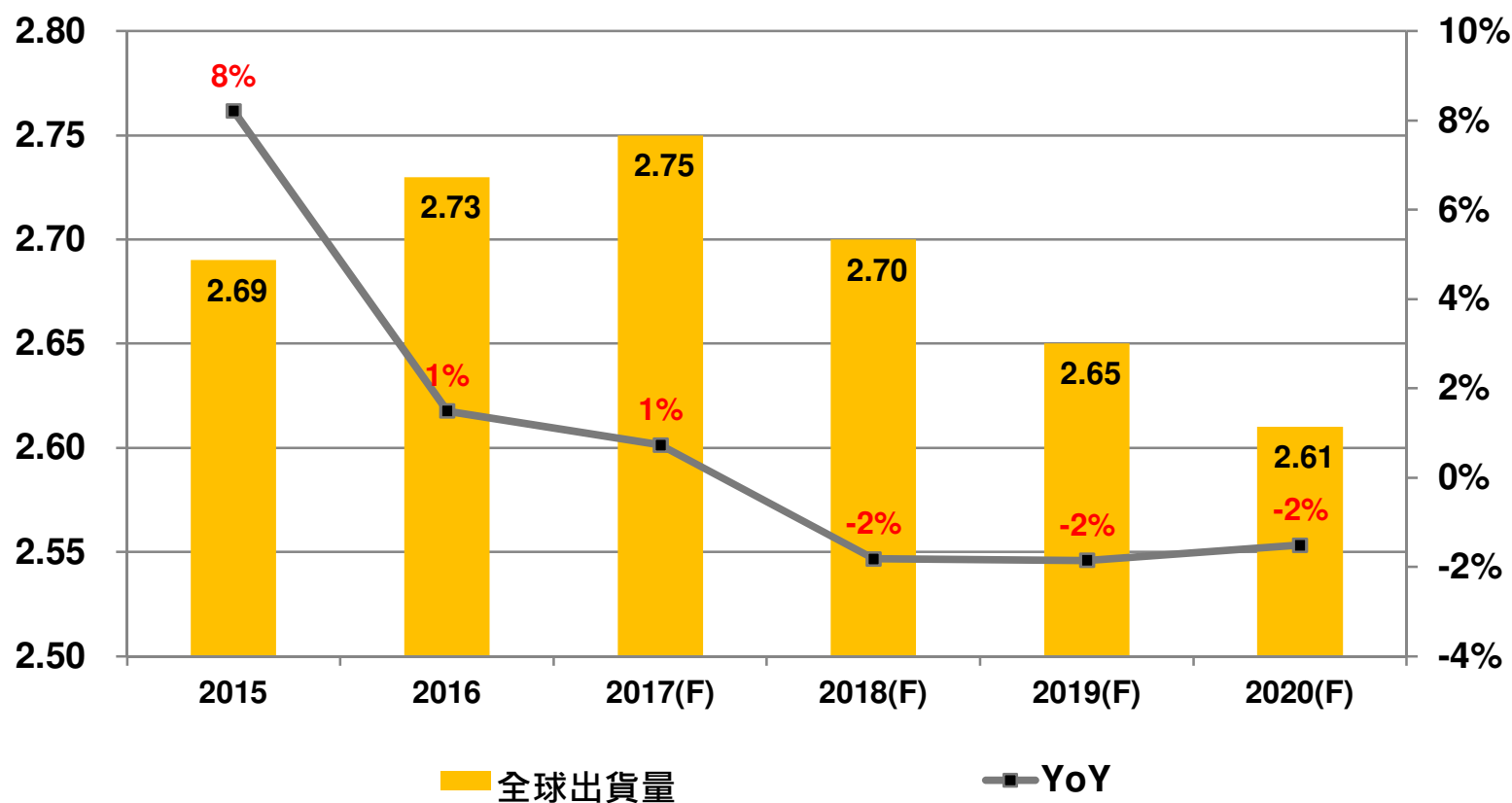
資料來源: DIGITIMES Research 2018/05

產業現況-機上盒

出貨量持續衰退,但AI將提升產品結構,推升單價

單位：億台

2015~2020年 全球STB出貨量



單位:億台	2015	2016	2017(F)	2018(F)	2019(F)	2020(F)
全球出貨量	2.69	2.73	2.75	2.70	2.65	2.61
YoY	8%	1%	1%	-2%	-2%	-2%

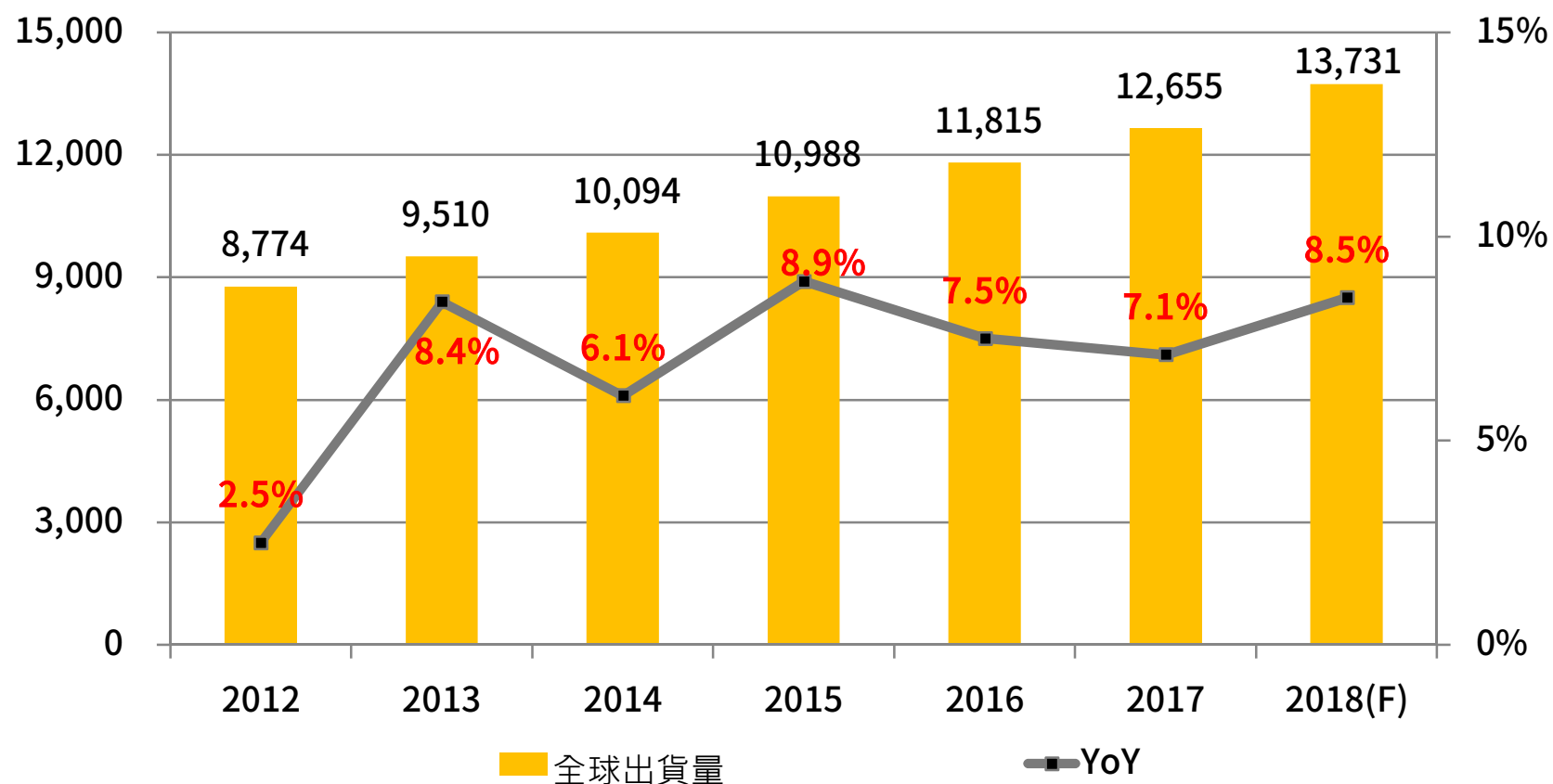
資料來源: SNL Kagan 2016/12

產業現況-伺服器

IoT+5G+AI =
需求持續成長

2012~2018年 全球伺服器出貨量

單位:千台



單位:千台	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018(F)
全球出貨量	8,774	9,510	10,094	10,988	11,815	12,655	13,731
YoY	2.5%	8.4%	6.1%	8.9%	7.5%	7.1%	8.5%

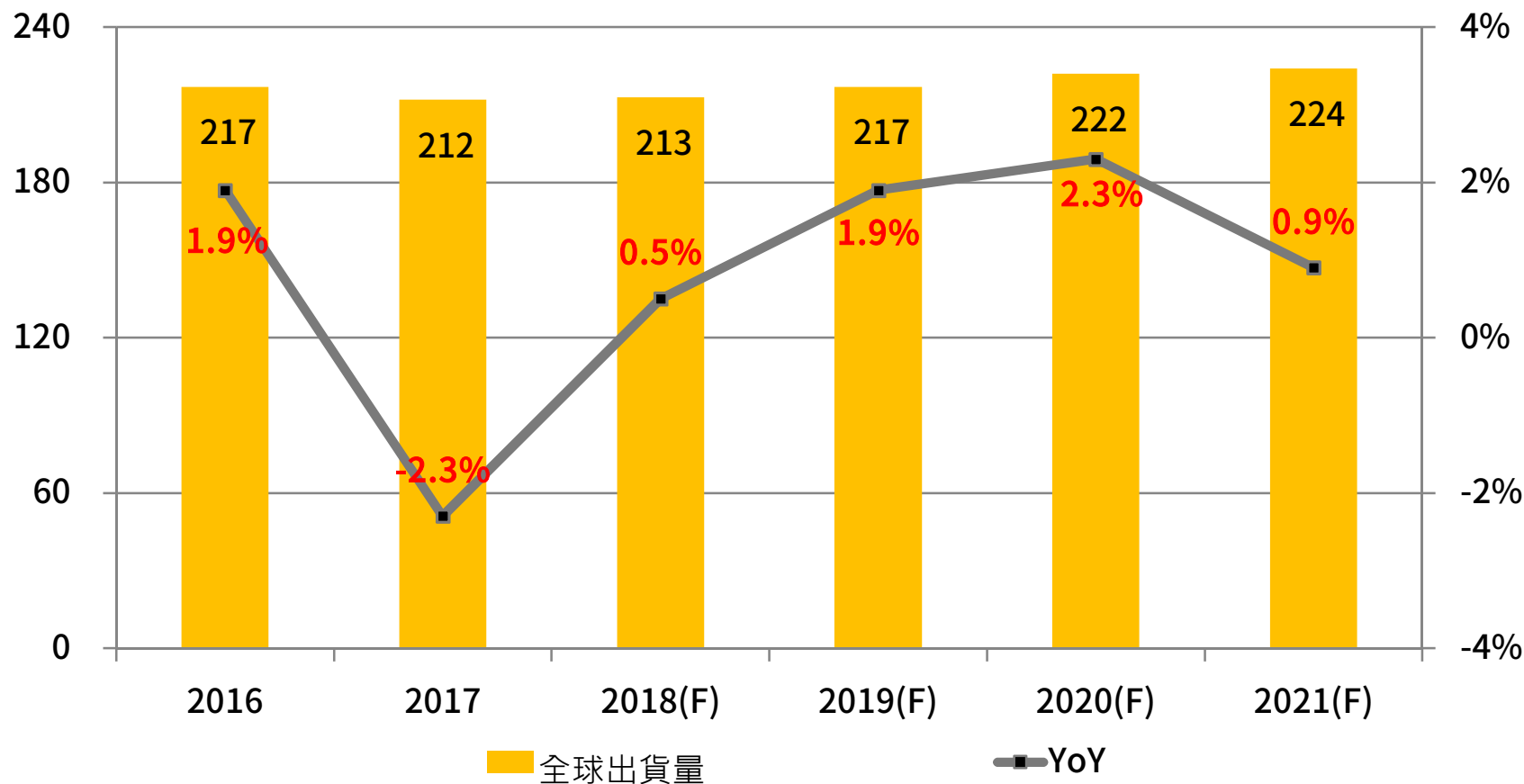
資料來源: DIGITIMES Research 2017/10

產業現況-TV

市場需求趨於穩定，
產品朝4K/8K發展

2016~2021年 全球LCD TV出貨量

單位:百萬台



單位:百萬台	2016	2017	2018(F)	2019(F)	2020(F)	2021(F)
全球出貨量	217	212	213	217	222	224
YoY	1.9%	-2.3%	0.5%	1.9%	2.3%	0.9%

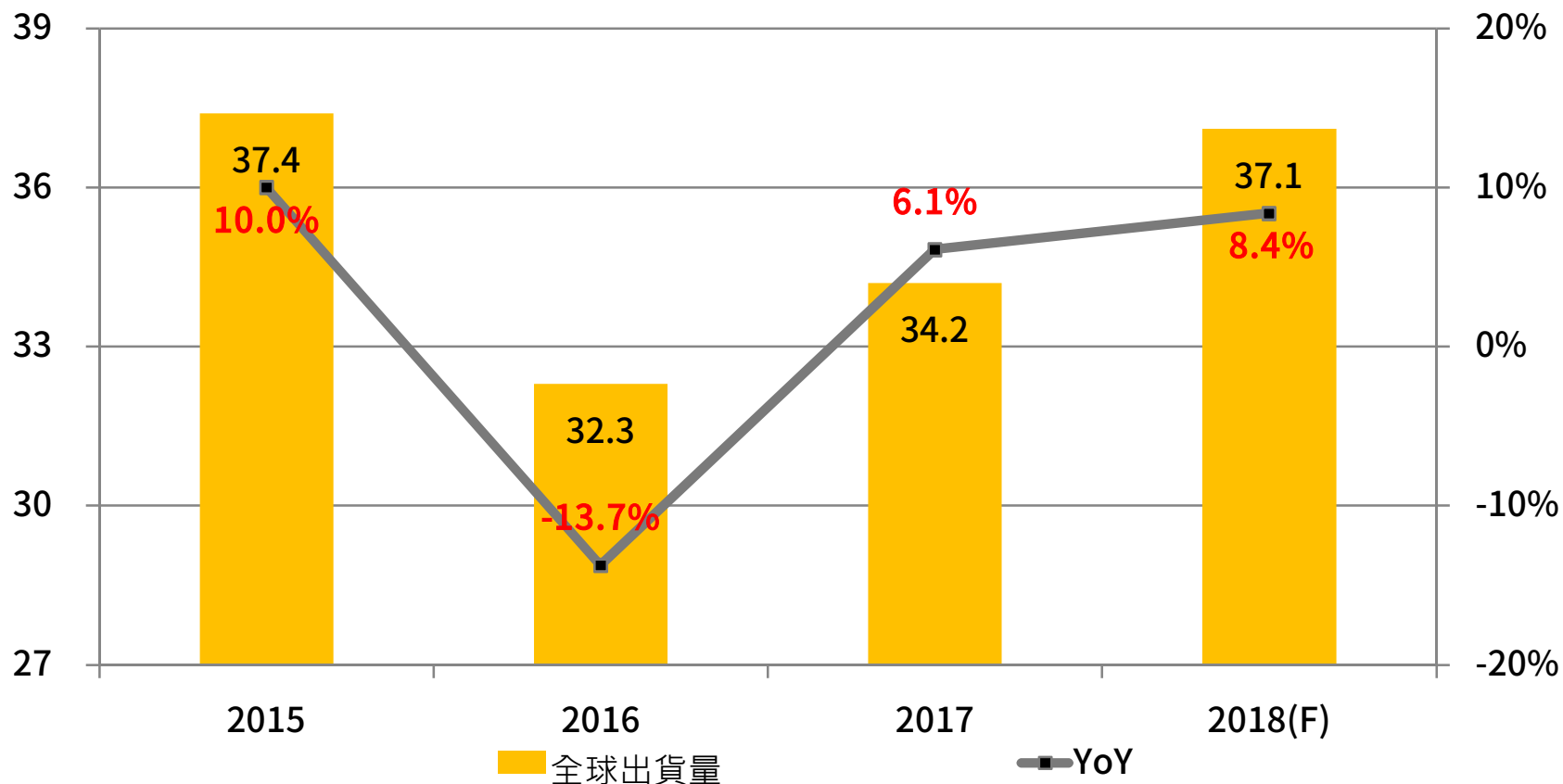
資料來源: DIGITIMES Research 2017/12

產業現況-遊戲機

需求持續成長,新應用將帶動成長動能

2015~2018年 全球遊戲機出貨量

單位:百萬台

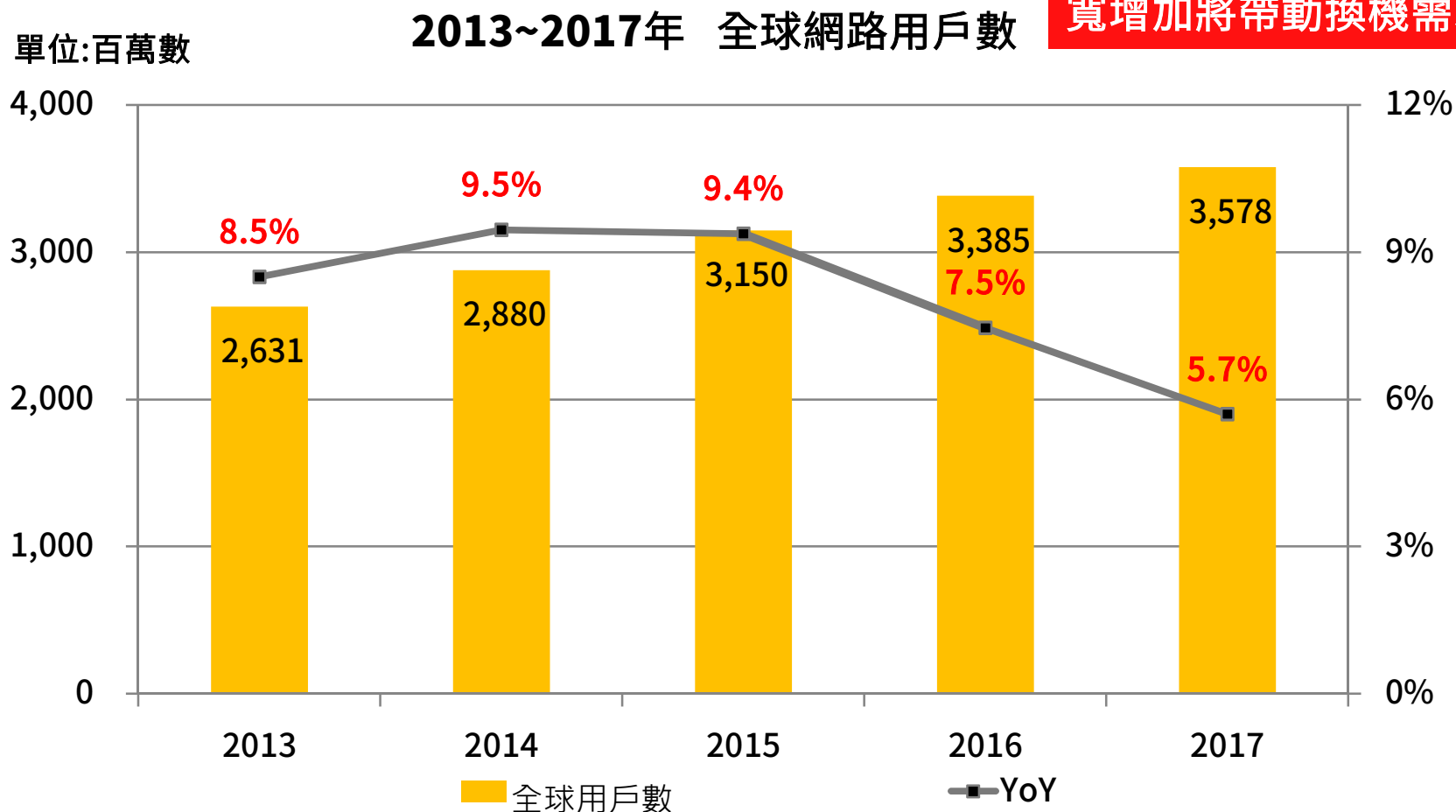


單位:百萬台	2015	2016	2017	2018(F)
全球出貨量	37.4	32.3	34.2	37.1
YoY	10.0%	-13.7%	6.1%	8.4%

資料來源: DIGITIMES Research 2018/02

產業現況-網通

全球用戶持續增長、頻寬增加將帶動換機需求



單位:百萬數	2013	2014	2015	2016	2017
全球用戶數	2,631	2,880	3,150	3,385	3,578
YoY	8.5%	9.5%	9.4%	7.5%	5.7%

資料來源: ITU 2017/08

新開發產品

IOT



- AI
- VR
- Home Audio

Networking



*RackSystem C2000 Enclosure



- Hub
- Router
- AP

Server



- Server
- Storage
- Switch

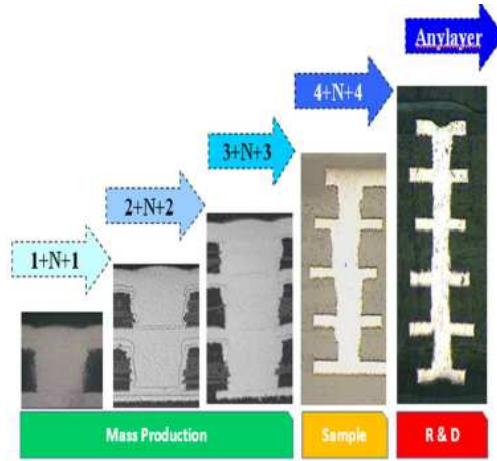
LCD



- TV
- NB
- Monitor

研發及未來方向

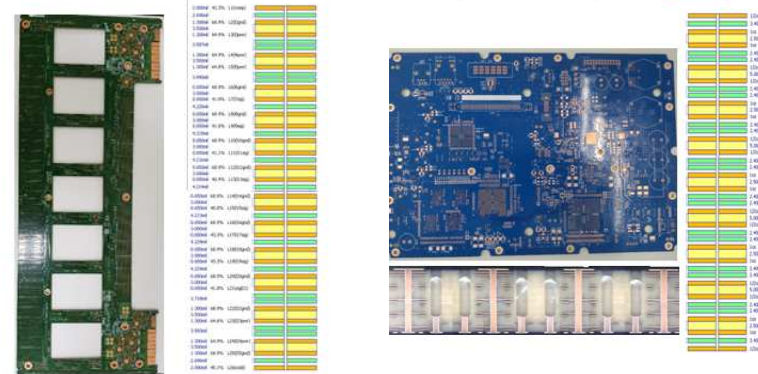
HDI



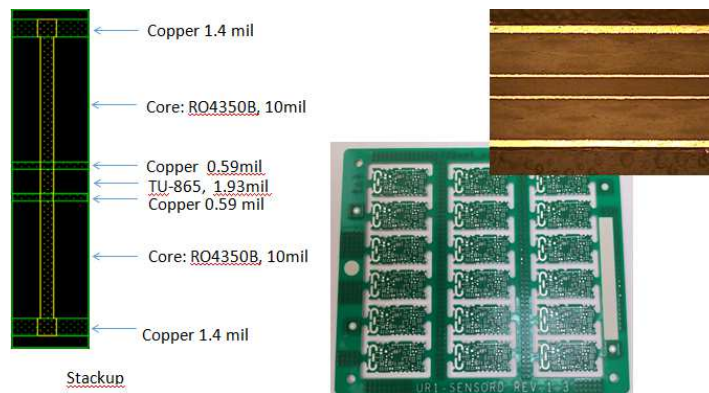
High Layer Count

Layer count	Material	Trace/space	A/R	Thickness
26L	EM-828G	3.5 / 4	11.1	111

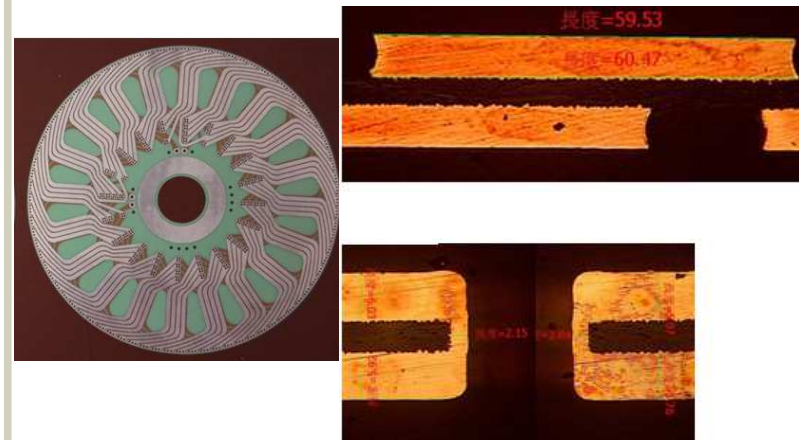
Layer count	Material	Trace/space	Thickness	Process
20L	EM-888 + VLP	4 / 4	93 mil	VIPPO + Backdrill



Hybrid & High Frequency Material



Embedded / Heavy Copper



Thank you!